

2026 年 9 月 16 日

2026 年 12 月期 第 2 四半期決算説明会 Q&A

1. 上期の受注が非常に強かった。下期および来年の受注見通しについて、半導体製造装置と表面処理用機器に分けて教えてほしい。

半導体製造装置では、コーター／デベロッパーとデボンドクリーナー（剥離・洗浄装置）が受注の大きなポイントになっています。第 1 四半期、第 2 四半期は受注が非常に増えましたが、第 3 四半期、第 4 四半期については、これまでと同じ水準が続くとは見ていません。一方、台湾のファウンドリーや OSAT の設備投資は今後も継続すると聞いており、受注がなくなるというより、上期ほどの水準ではないものの、ある程度は継続すると見ています。表面処理用機器は、めっき装置を中心とするウェットプロセスと基板搬送に分けて考えています。めっき装置は製造できるメーカーが少なく、需要に対して供給量が不足しているとの話があります。当社にも次の受注が入る可能性があると考えていますが、具体的な案件や金額が見えているわけではなく、現在の製造能力の範囲で受けられる案件を受けていく考えです。基板搬送については、ベトナム工場の拡張と設備投資により生産能力を増やしており、今後も受注水準を引き上げられると期待しています。

2. 2027 年の受注は、どのような方向感で見ているか。

現在の受注案件は、実際の納入と売上計上が来年になります。そのため、受注水準は現在より少し落ち着くと見ています。一方で、当社は製品群を増やして事業を広げる必要があり、新たな取り組みによる受注拡大も必要です。ただし、金額ベースで現在の高い水準がそのまま続くとは、現時点では見ていません。

3. 受注が強く、来年以降に売上が大きく拡大した場合、どこまで対応できるか。半導体製造装置と表面処理用機器に分け、生産能力拡大のロードマップを教えてほしい。

ユニット、モジュール、部品加工については、TAZMO VIETNAM の工場拡張と人員増強を進めています。表面処理用機器の搬送・基板関連と、タツモ本体の搬送装置では、ベトナム拠点が生産能力を増やすうえで大きな役割を担います。半導体製造装置については社内をフル稼働させていますが、最も重要なのは協力会社との連携です。数年前から取り組み、昨年から今年にかけても、さらに多くの協力会社と連携できるようになりました。表面処理用機器のウェット装置については、中国の東莞にある主力生産工場と外注先を活用して生産能力を確保する予定です。

4. 研究開発費、設備投資、減価償却費について、上期実績と通期計画に変更がないか教えてほしい。また、上期実績の具体的な数値を確認したい。

研究開発費の計画に大きな変更はありません。要素開発がある程度終わり、その成果を基に実験用装置やデモ機を作る取り組みが増えているため、昨年までと比べて使用額は大きく増えています。固定資産への投資では、台湾に設備を構え、デモ機を置いて顧客評価やサービス・サポートに対応する計画を進めています。上期の研究開発費は単体で5億4,100万円で、前年同期から約3億円増加しています。有形固定資産の取得による支出は約13億円です。主な内容はデモ機と台湾の設備取得に伴う前渡金です。

5. 検収遅れが売上減少の要因との説明があった。一方で通期業績予想は据え置いている。今後も一定の検収遅れが発生することを前提に、通期計画を組んでいるのか。

一定の検収遅れを通期計画に織り込んでいるわけではありません。今回の遅れは、開発要素が高い特定の一部装置で発生したものです。遅れをどう取り戻すかという点では、搬送装置の受注が大きく伸びています。搬送装置はリードタイムが短く、今期に受注し、今期中に売上計上できる案件が計画より増える可能性があります。これも踏まえ、通期ではおおむね計画に沿って進められると見ています。

6. 四半期および通期の業績が大きく上下している。国内外の投資家への情報発信をどのように組み立てるのか。

外部から売上、利益、受注の四半期ごとの変動を見て、当社の状況を把握するのは非常に難しいと認識しています。当社は大手装置メーカーと中小装置メーカーの中間に位置し、OEMではなく、顧客へ直接装置を販売するビジネスです。多様な装置をそろえ、景気変動の影響を抑えながら、それぞれを着実に販売し、事業を安定的に伸ばすことが重要です。装置・設備投資ビジネスである以上、半導体市況には山谷があります。その中で安定性を高めるには、製品ラインアップを多様化するとともに、まとまった受注に対応できるサプライチェーンを構築しておく必要があります。外部から分かりにくい部分については、今後もしっかり説明し、理解を得られるようにしたいと考えています。

7. 先端パッケージ需要の拡大により、台湾では一部工程をOSATへ委託していると聞く。最近も関連する引き合いが来ているのか。

台湾のOSATへ仕事が流れ、OSAT各社が設備投資を加速し、設備を強化している状況です。その影響を受け、当社にも台湾のOSATから仕事が来ています。先端パッケージ関連ではデボンドクリーナー（剥離・洗浄装置）およびコーター／デベロッパーに関する引き合いと受注をいただいています。

8. 第2四半期の表面処理用機器の受注は93億円で、約3割が基板搬送、残りがめっき処理などの装置との説明だった。タツモ本体のプロセス機器事業にも搬送装置セグメントがあるが、両者はどのように違うのか。

表面処理用機器事業に分類している基板搬送は、主にプリント基板や多層・積層基板を搬送する装置で、半導体のシリコンウェーハ搬送ではありません。一方、タツモ本体の搬送装置が扱うのは、ガラス基板、シリコンウェーハ、マスクなど、半導体プロセスで使われるものです。

9. 今回のプリント基板、多層基板、パッケージ基板向け受注は、数年前の大型受注があった時と比べ、装置のサイズ感に変化はあるか。

装置のサイズ感に大きな変化はありません。ただし、受注の傾向は異なります。前回は搬送系の割合が比較的大きく、顧客の傾向や種類、搬送装置の内容も今回とは異なっていました。今回は搬送装置も相応に大きいものの、当社が特に注目しているのは、ウェットプロセスのめっき装置をある程度まとまって受注できたことです。

10. 今回に限らず、めっき装置を含む表面処理用機器の受注は今後も続く感触が強いのか。それとも不透明か。

今後も続くと思っています。先端パッケージには、それを載せるプリント基板が必ず必要です。AIを含む先端パッケージ市場が拡大する中、それを支えるプリント基板の需要も伸びると考えています。EVや自動車の電装化は足元でやや足踏みしている印象もありますが、長期では市場が伸びると見ています。また、エッジAIやフィジカルAIでは、ハイエンドのプロセッサやパッケージを支える基板の重要性がさらに高まります。来期だけでなく、もう少し長い目で見ると、表面処理用機器事業には成長余地があると考えています。

11. DTB（ダイレクト・トランスファー・ボンディング）とLAB（レーザー・アシスト・ボンダー）の事業化は、数年先という理解でよいのか。

DTB（ダイレクト・トランスファー・ボンディング）は、チップ・オン・ウェーハ向けのボンダーです。2026年5月には米国のECTCでパネル展示を行い、多くの質問や情報提供をいただきました。新技術を提案する活動は着実に進めています。LAB（レーザー・アシスト・ボンダー）はMEMS向けでもあり、実験機からα機を製作し、具体的な販売に向けて動く段階に入っています。全体の受注に占める割合はごくわずかですが、第2四半期に1台を受注しました。今後、販売を少しずつ広げられると期待しています。

12. 第2四半期のコーター／デベロッパー受注は従来と規模が大きく異なる。顧客は1社か複数社か、また OSAT 向けなのか。受注が従来の10億円程度から大きく増えた背景も説明してほしい。

当社は以前から、台湾の OSAT 向けにコーター／デベロッパーを継続して納入してきました。その実績が今回の受注につながったと考えています。顧客は台湾の OSAT のうち、限られた会社です。受注増加の要因は二つあると見ています。一つは、PC やタブレット向けなど、従来型のウェーハレベルパッケージ需要が増えていることです。もう一つは、台湾のファウンドリーから OSAT へ先端パッケージの一部工程が流れる中で、当社のコーター／デベロッパーを使用する工程があると見られることです。現時点では、この二つが今回の大型受注の主な要因だと推察しています。

13. コーター／デベロッパーの利益率は、剥離・洗浄装置と比べてどうか。大量受注のリードタイムを適切に管理できれば、同程度のマージンを期待できるか。

コーター／デベロッパーの利益率は、剥離・洗浄装置と比べて大きく変わらないと考えています。安定的に利益を確保できる受注になる見込みです。ボリュームメリットは確実にあります。売上が伸び、一定の仕様の装置をまとめて受注できることは、会社の収益に大きくつながると見ています。

以上